



泰碩電子(股)公司 法人說明會

(股票代號：3338)

風險事項提醒

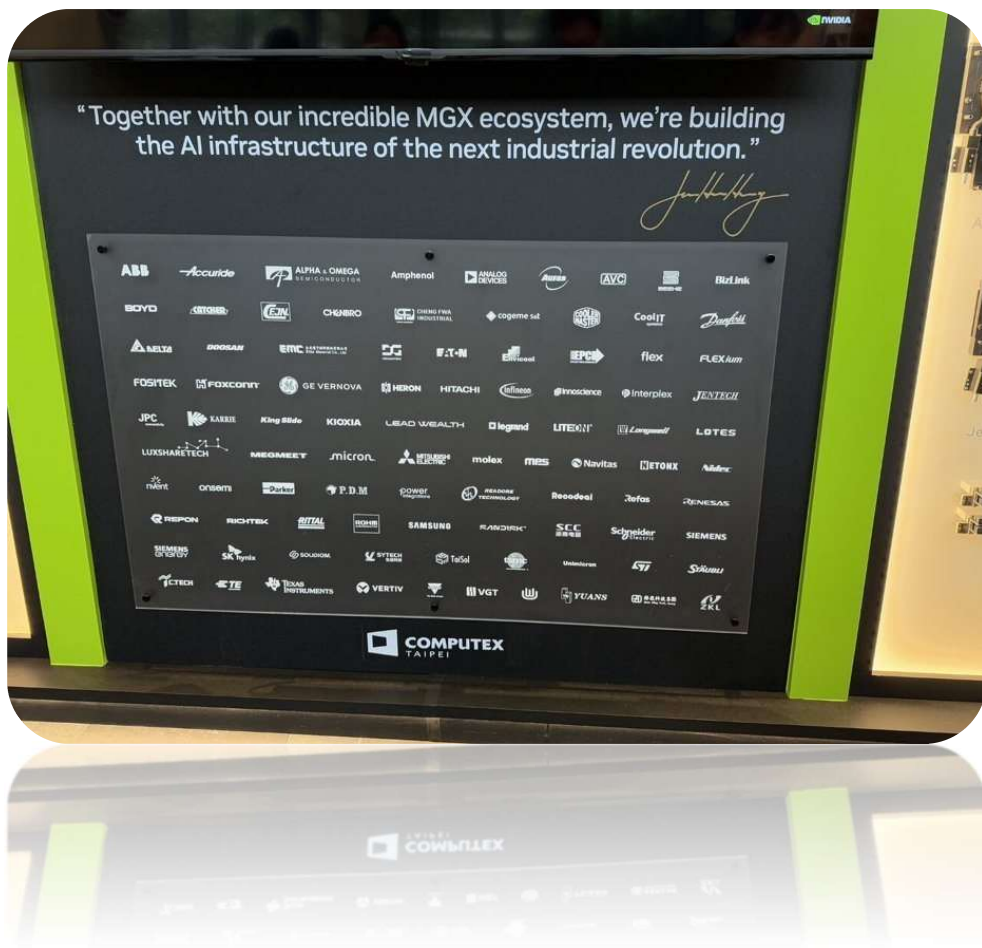
- 本簡報由 泰碩電子股份有限公司 (本公司)提供，本簡報所含資料僅以當時之情況為準，本公司不會就本文公開後所發生任何變動更新或修正內容。
- 本簡報資料含有前瞻性敘述。這些前瞻性敘述將受風險、不確定性、假設或其它因素影響，有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
- 本簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證證券或金融商品的邀約、邀約之引誘或建議。

議程

01 **2026年 Q1 營運成果**

02 **未來展望**

03 **Q & A**



01

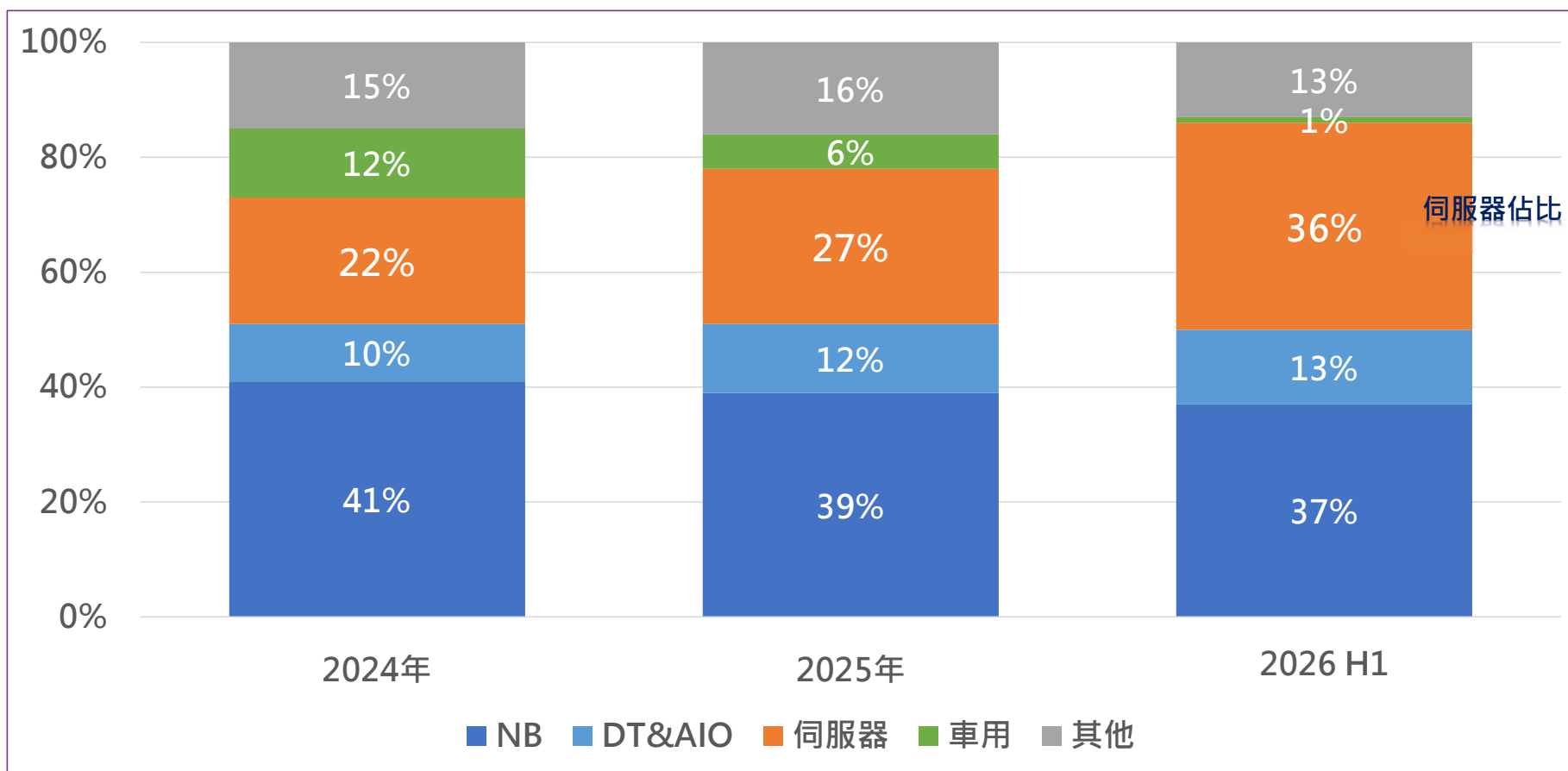
2026 Q1營運成果

合併綜合損益表

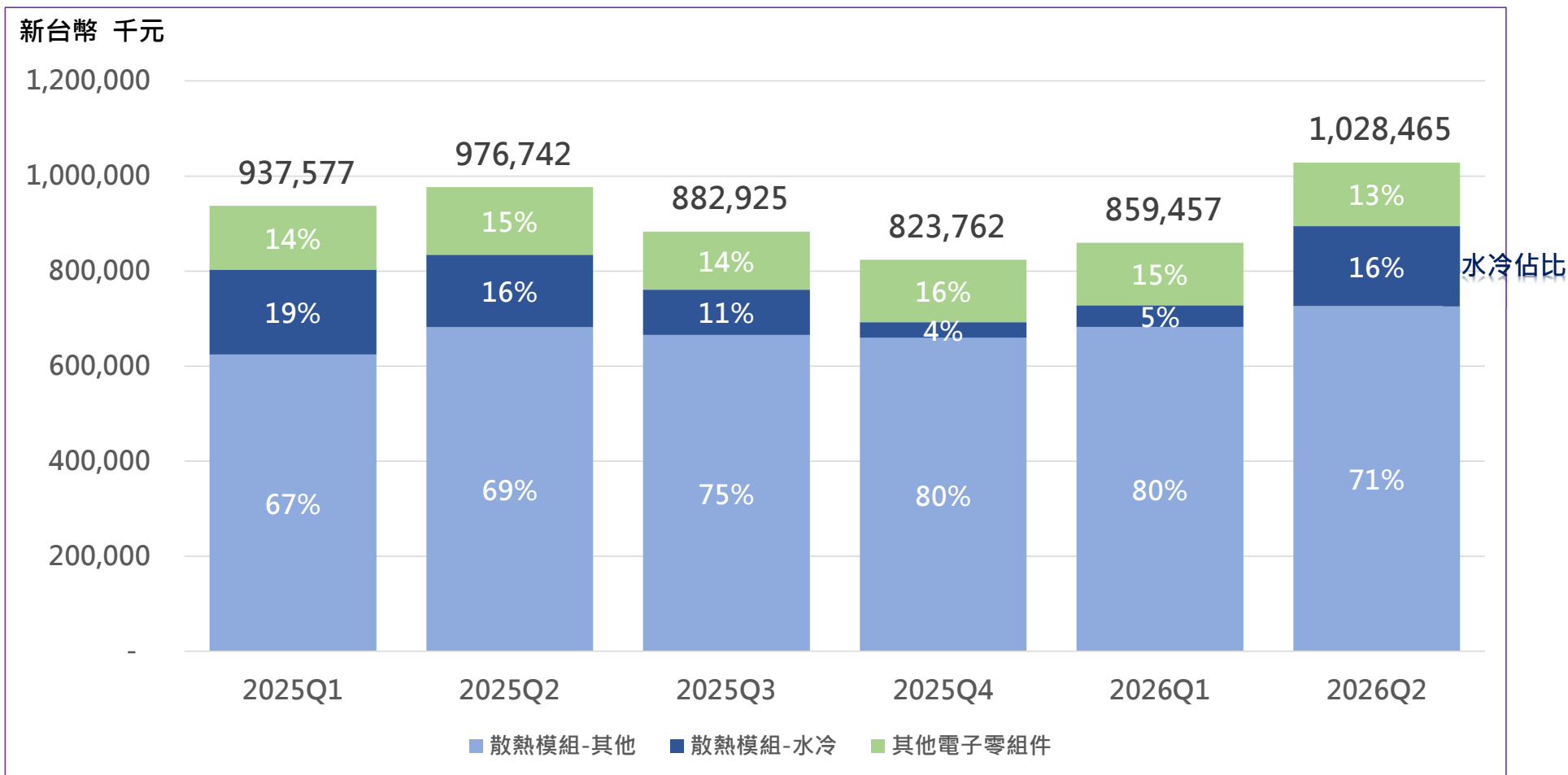
新台幣 千元

	2026年1~3月		2025年 10~12月		季成長	2025年1~3月		年成長
營業收入	859,457	100%	823,762	100%	4%	937,577	100%	-8%
營業毛利	163,158	19%	176,513	21%		186,294	20%	
營業費用	136,399	16%	140,253	17%		130,859	14%	
營業淨利	26,759	3%	36,260	4%		55,435	6%	
營業外收支	(998)	0%	(1,482)	0%		13,693	1%	
稅前淨利	25,761	3%	34,778	4%	-26%	69,128	7%	-63%
所得稅費用	2,499	0%	4,190	0%		16,192	2%	
本期淨利	23,262	3%	30,588	4%		52,936	5%	
淨利歸屬於母公司業主	23,262	3%	30,588	4%	-24%	52,936	5%	-56%
EPS (新台幣元)	0.27		0.36			0.61		

合併營收 - 應用大類佔比%



合併營收 - 產品大類佔比%





02

未來展望

引領綠色算力革命：NVIDIA 新世代平台之液冷布局



泰碩具備「零組件到 CDU 系統」全鏈條整合實力

攜手 NVIDIA 共同研發 2.6MW 超高功率 L2L (液對液) CDU。專為 NVIDIA MGX 世代高功率平台 量身打造。



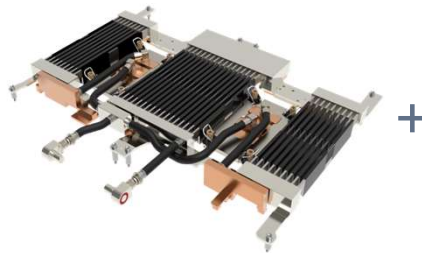
NVIDIA B300

Inner Manifold



NVIDIA B300

CPU Liquid Cooling Module



NVIDIA R200

DIMM Liquid Cooling Module

+



In-Row 2.6MW
液冷 CDU (800VDC)



In-Row CDU (L2L)
200~500kW



In Rack CDU (L2L)
120~250 kW

01 核心散熱技術

- 液冷板 | 熱管 | VC | 精密焊接
- 通過嚴格可靠度測試，掌握高熱密度產品開發能力



02 高規格液冷模組

- 整合水冷板、分流通、管路與快速接頭
- 對應 NV 及各大廠高規格液冷平台



03 資料中心液冷系統

- 2.6MW L2L 解熱能力，支援 800VDC 架構
- 從模組到系統級 (CDU) 完整解決方案

AI 機櫃功耗提升 → 液冷滲透率持續拉高 → 泰碩技術延伸模組：高功率 CDU & 機櫃級液冷整合

AI革命：NVIDIA 專用 800VDC 高壓液冷 CDU

隨著 AI 機櫃功耗劇增，大算力資料中心對「液冷基礎設施」需求迎來爆發式成長。
泰碩成功轉型，推出專為 NVIDIA 架構設計的 800VDC 高壓液冷 CDU 系統。

應用端

資料中心
液冷基礎設施



泰碩核心系統 In-Row 2.6MW 液冷 CDU (800VDC)

高功率設計 | 水路整合 | 可靠性驗證



泰碩關鍵組件

Cold Plate
Manifold
液冷管

泰碩具備高功率 800VDC L2L CDU 研發能力，以完整水路設計，全面支援新一代 AI 資料中心。

2.6MW 高功率冷卻能力

- 對應滿足 AI 熱負載
- 展現系統整合力

800VDC 高壓直流對應

- 支援新一代架構
- 大幅提高 CDU 技術門檻與競爭

可靠性與量產驗證

- 嚴格全項測試(壓力/氣密/熱阻)
- 快速導入供應鏈，幫客戶快速出貨。

AI 資料中心功耗升級，催化液冷散熱需求

AI 晶片功耗激增，液冷已成新一代資料中心必然標配。
泰碩全面 Ready！一站式支援下一代高功率 AI 運算平台。

01

高效能冷板技術

- 精準流道設計與真空銲接，實現極致熱阻平衡。
- 完美對應新世代超高功率CPU / GPU 核心熱源。

02

機櫃水路與結構整合

- 高度整合Manifold、管路、快接頭與機架。
- 支援模組化設計，協助客戶系統快速導入。

03

品質與可靠度驗證

- 通過氦氣測漏、高壓、流量與溫度極限測試
- 嚴格執行熱循環與老化測試，確保零失效風險。

提供高功率 AI 液冷一站式配套方案，加速客戶量產時程

全方位液冷佈局：從核心元件走向系統級整合

以核心元件技術為基礎，彈性延伸至高密度系統級液冷與高整合度 All-in-One 液冷模組，滿足多元功耗需求。

01 Liquid Cooling Module for AI Servers (8卡)

Total Power: 4.53 kW

8 x GPU and CPU
2 x Switch
2 x PSU

02 GPU + Switch Liquid Cooling Solution

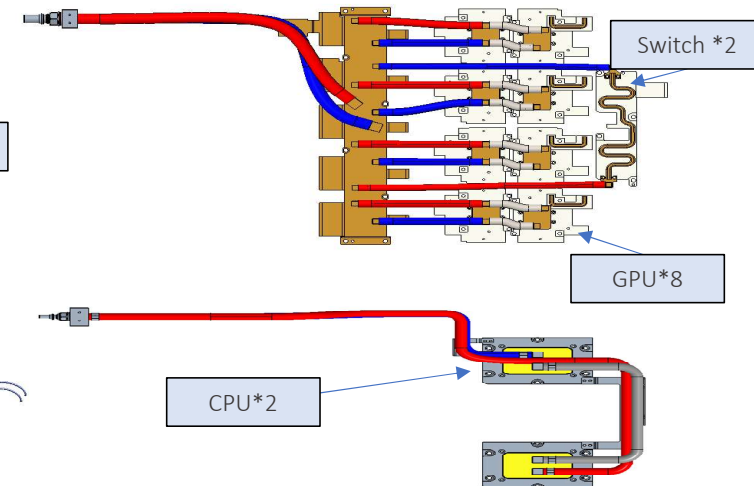
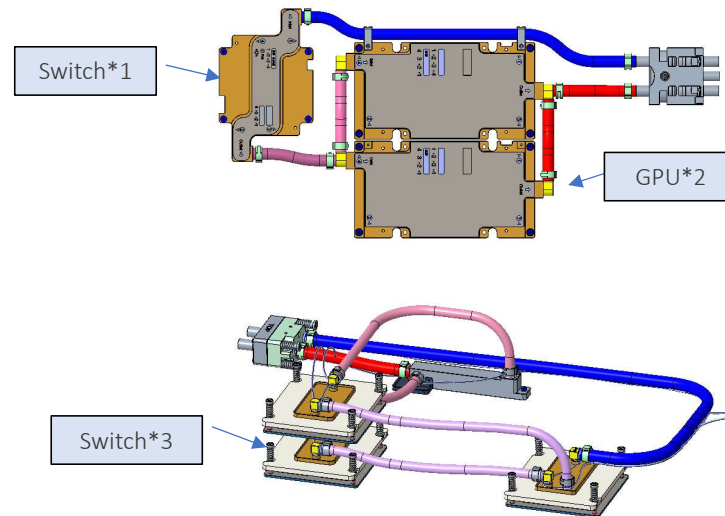
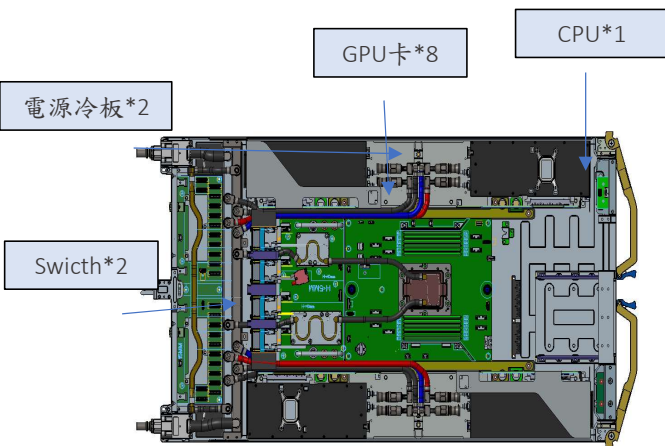
Total Power: 2.58 kW

2 x CPU
4 x Switch

03 All-in-One Liquid Cooling Module

Total Power: 3.43 kW

8 x GPU and 2 x CPU
4 x Switch



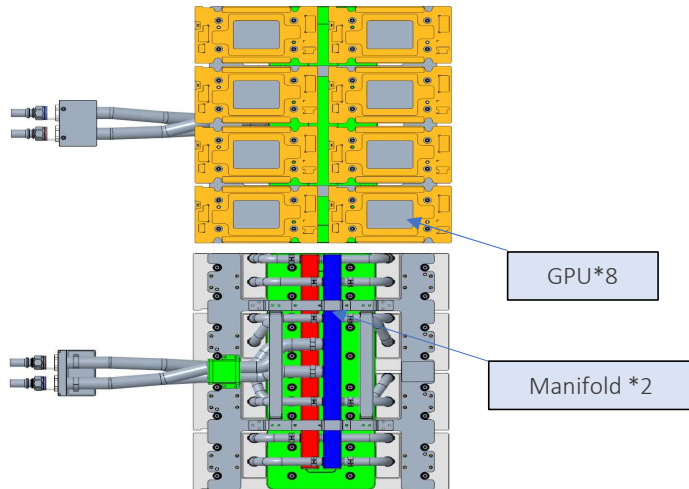
全方位液冷佈局：從核心元件走向系統級整合

以核心元件技術為基礎，彈性延伸至高密度系統級液冷與高整合度 All-in-One 液冷模組，滿足多元功耗需求。

04 Rack-Level 8-GPU Liquid Cooling Module

Total Power: 6.80 kW

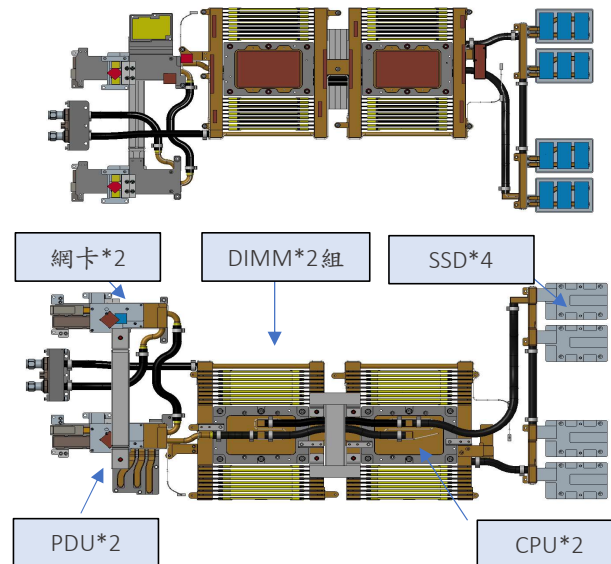
8 x GPU
Inner Manifold



05 All-in-One Liquid Cooling Module

Total Power: 2.67 kW

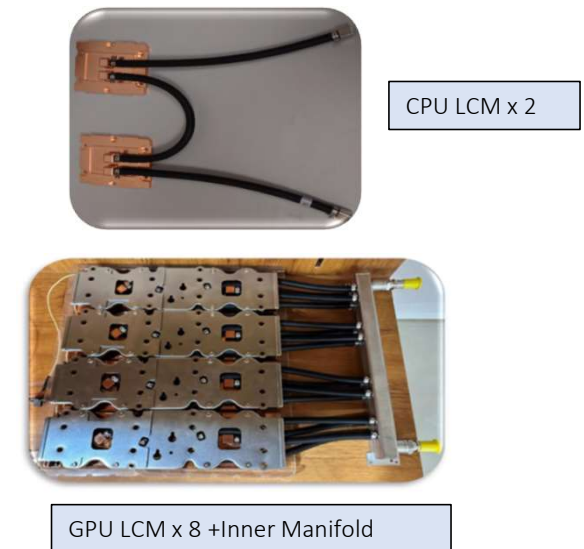
Dual-GPU and 32 x DIMM
PDU 電源分配
NIC 高頻智慧網卡
4 x NVMe SSD

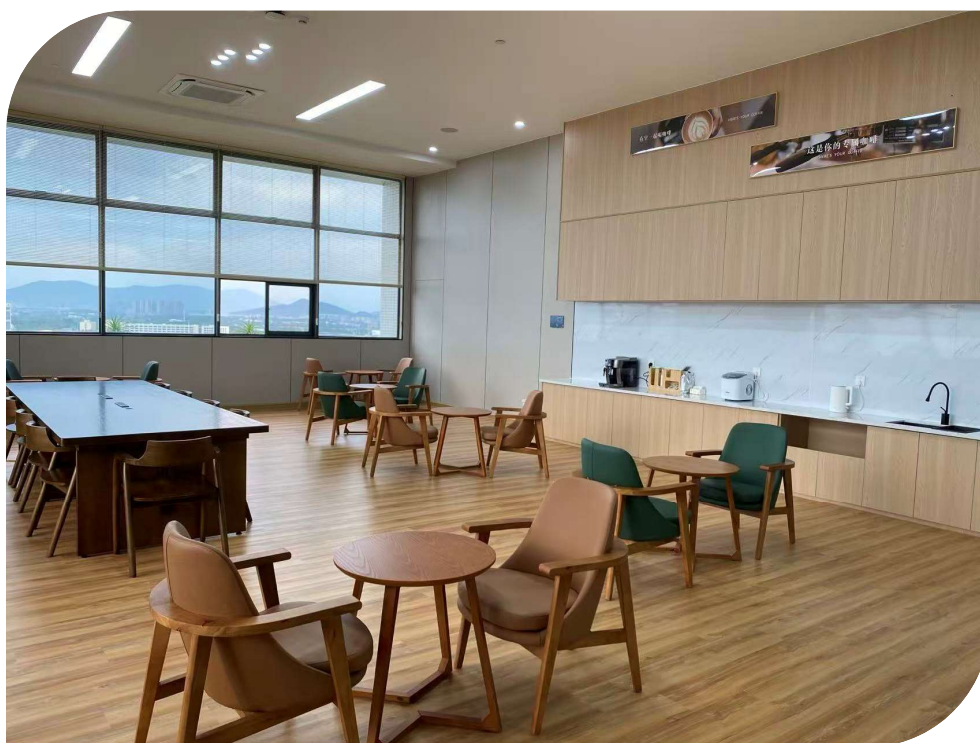


06 AMD Instinct™ MI355 Liquid Cooling Module

Total Power: 1.22 kW

2 x AMD EPYC™ CPU
8 x AMD MI355 GPU





03

Q & A

Thanks!

如需更多資訊，請上www.taisol.com